

2022-2028年中国芯片设计 市场深度分析与市场年度调研报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2022-2028年中国芯片设计市场深度分析与市场年度调研报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202206/302515.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2022-2028年中国芯片设计市场深度分析与市场年度调研报告》共十一章。首先介绍了芯片设计行业市场发展环境、芯片设计整体运行态势等，接着分析了芯片设计行业市场运行的现状，然后介绍了芯片设计市场竞争格局。随后，报告对芯片设计做了重点企业经营状况分析，最后分析了芯片设计行业发展趋势与投资预测。您若想对芯片设计产业有个系统的了解或者想投资芯片设计行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 芯片设计行业相关概述

1.1 芯片的概念和分类

1.1.1 芯片基本概念

1.1.2 相关概念区分

1.1.3 芯片主要分类

1.2 芯片产业链结构

1.2.1 芯片产业链结构

1.2.2 芯片生产流程图

1.2.3 产业链核心环节

1.3 芯片设计行业概述

1.3.1 芯片设计行业简介

1.3.2 芯片设计基本分类

1.3.3 芯片设计产业图谱

第二章 2016-2020年中国芯片设计行业发展环境

2.1 经济环境

2.1.1 宏观经济发展概况

2.1.2 工业经济运行情况

2.1.3 经济转型升级态势

- 2.1.4 未来经济发展展望
- 2.2 政策环境
 - 2.2.1 智能制造发展战略
 - 2.2.2 中国制造支持政策
 - 2.2.3 集成电路相关政策
 - 2.2.4 芯片产业政策汇总
 - 2.2.5 产业投资基金支持
- 2.3 社会环境
 - 2.3.1 移动网络运行状况
 - 2.3.2 电子信息制造规模
 - 2.3.3 研发经费投入增长
 - 2.3.4 科技人才队伍壮大
- 2.4 技术环境
 - 2.4.1 芯片领域专利状况
 - 2.4.2 芯片技术数量分布
 - 2.4.3 芯片技术研发进展
 - 2.4.4 芯片技术创新升级
 - 2.4.5 芯片技术发展方向

第三章 2016-2020年中国芯片产业发展分析

- 3.1 2016-2020年中国芯片产业发展综述
 - 3.1.1 产业基本特征
 - 3.1.2 产业发展背景
 - 3.1.3 产业发展意义
 - 3.1.4 产业发展进程
 - 3.1.5 产业发展提速
- 3.2 2016-2020年中国芯片市场运行状况
 - 3.2.1 产业销售规模
 - 3.2.2 市场结构分析
 - 3.2.3 产品产量规模
 - 3.2.4 企业竞争状况
 - 3.2.5 区域发展格局

- 3.2.6 市场应用需求
- 3.3 2016-2020年中国集成电路所属行业进出口数据分析
 - 3.3.1 进出口总量数据分析
 - 3.3.2 主要贸易国进出口情况分析
 - 3.3.3 主要省市进出口情况分析
- 3.4 2016-2020年中国芯片国产化进程分析
 - 3.4.1 芯片国产化发展背景
 - 3.4.2 核心芯片的自给率低
 - 3.4.3 芯片国产化进展分析
 - 3.4.4 芯片国产化存在问题
 - 3.4.5 芯片国产化未来展望
- 3.5 中国芯片产业发展困境分析
 - 3.5.1 市场垄断困境
 - 3.5.2 过度依赖进口
 - 3.5.3 技术短板问题
 - 3.5.4 人才短缺问题
- 3.6 中国芯片产业应对策略分析
 - 3.6.1 突破垄断策略
 - 3.6.2 化解供给不足
 - 3.6.3 加强自主创新
 - 3.6.4 加大资源投入

第四章 2016-2020年芯片设计行业发展全面分析

- 4.1 2016-2020年全球芯片设计行业发展综述
 - 4.1.1 市场发展规模
 - 4.1.2 市场区域格局
 - 4.1.3 市场竞争格局
 - 4.1.4 企业排名分析
- 4.2 2016-2020年中国芯片设计行业运行状况
 - 4.2.1 行业发展历程
 - 4.2.2 市场发展规模
 - 4.2.3 市场竞争格局

- 4.2.4 产品类型分布
- 4.2.5 细分市场发展
- 4.3 芯片设计企业发展状况分析
 - 4.3.1 企业数量规模
 - 4.3.2 企业运行状况
 - 4.3.3 企业地域分布
 - 4.3.4 设计人员规模
- 4.4 芯片设计行业上市公司财务状况分析
 - 4.4.1 上市公司规模
 - 4.4.2 上市公司分布
 - 4.4.3 经营状况分析
 - 4.4.4 盈利能力分析
 - 4.4.5 营运能力分析
 - 4.4.6 成长能力分析
 - 4.4.7 现金流量分析
- 4.5 芯片设计具体流程剖析
 - 4.5.1 规格制定
 - 4.5.2 设计细节
 - 4.5.3 逻辑设计
 - 4.5.4 电路布局
 - 4.5.5 光罩制作
- 4.6 芯片设计行业发展存在的问题和对策
 - 4.6.1 行业发展瓶颈
 - 4.6.2 行业发展困境
 - 4.6.3 产业发展建议
 - 4.6.4 产业创新策略

第五章 2016-2020年中国芯片设计行业细分产品发展分析

- 5.1 逻辑IC产品设计发展状况
 - 5.1.1 CPU
 - 5.1.2 GPU
 - 5.1.3 MCU

- 5.1.4 ASIC
- 5.1.5 FPGA
- 5.1.6 DSP
- 5.2 存储IC产品设计发展状况
 - 5.2.1 DRAM
 - 5.2.2 NAND Flash
 - 5.2.3 NOR Flash
- 5.3 模拟IC产品设计发展状况
 - 5.3.1 射频器件
 - 5.3.2 模数/数模转换器
 - 5.3.3 电源管理产品

第六章 中国芯片设计工具——EDA（电子设计自动化）软件市场发展状况

- 6.1 EDA软件基本概述
 - 6.1.1 EDA软件基本概念
 - 6.1.2 EDA软件的重要性
 - 6.1.3 EDA软件主要类型
 - 6.1.4 EDA软件设计过程
 - 6.1.5 EDA软件设计步骤
- 6.2 中国芯片设计EDA软件行业发展分析
 - 6.2.1 行业发展规模
 - 6.2.2 市场竞争状况
 - 6.2.3 国产EDA机遇
 - 6.2.4 行业发展瓶颈
 - 6.2.5 行业发展对策
- 6.3 集成电路EDA行业竞争状况
 - 6.3.1 市场竞争格局
 - 6.3.2 国际EDA企业
 - 6.3.3 国内EDA企业
- 6.4 EDA技术及工具发展沿革及作用
 - 6.4.1 GDS&GDS II
 - 6.4.2 SPICE

6.4.3 半导体器件模型 (SPICE Model)

6.4.4 硬件描述语言 (HDL)

6.4.5 静态时序分析

第七章 中国芯片设计产业园区建设分析

7.1 深圳集成电路设计应用产业园

7.1.1 园区发展环境

7.1.2 园区基本简介

7.1.3 园区战略定位

7.1.4 园区服务内容

7.2 北京中关村集成电路设计园

7.2.1 园区发展环境

7.2.2 园区基本简介

7.2.3 园区战略定位

7.2.4 园区发展状况

7.2.5 园区企业合作

7.2.6 园区发展规划

7.3 上海集成电路设计产业园

7.3.1 园区发展环境

7.3.2 园区基本简介

7.3.3 园区入驻企业

7.3.4 园区项目建设

7.3.5 园区发展规划

7.4 无锡国家集成电路设计产业园

7.4.1 园区发展环境

7.4.2 园区基本简介

7.4.3 园区发展状况

7.4.4 园区区位优势

7.5 杭州集成电路设计产业园

7.5.1 园区发展环境

7.5.2 园区基本简介

7.5.3 园区签约项目

7.5.4 园区发展规划

第八章 国外芯片设计重点企业经营状况

8.1 博通 (Broadcom)

8.1.1 企业发展概况

8.1.2 企业经营状况

8.1.3 产品研发动态

8.1.4 企业发展战略

8.2 高通 (Qualcomm)

8.2.1 企业发展概况

8.2.2 企业经营状况

8.2.3 产品研发动态

8.2.4 企业发展战略

8.3 英伟达 (NVIDIA)

8.3.1 企业发展概况

8.3.2 企业经营状况

8.3.3 产品研发动态

8.3.4 企业发展战略

8.4 超微 (AMD)

8.4.1 企业发展概况

8.4.2 企业经营状况

8.4.3 产品研发动态

8.4.4 企业发展战略

8.5 赛灵思 (Xilinx)

8.5.1 企业发展概况

8.5.2 企业经营状况

8.5.3 产品研发动态

8.5.4 企业发展战略

第九章 国内芯片设计重点企业经营状况

9.1 联发科

9.1.1 企业发展概况

- 9.1.2 企业经营状况
- 9.1.3 企业芯片平台
- 9.1.4 企业研发项目
- 9.2 华为海思
 - 9.2.1 企业发展概况
 - 9.2.2 企业经营状况
 - 9.2.3 企业芯片平台
 - 9.2.4 企业研发项目
- 9.3 紫光展锐
 - 9.3.1 企业发展概况
 - 9.3.2 企业经营状况
 - 9.3.3 企业芯片平台
 - 9.3.4 企业研发项目
- 9.4 中兴微电子
 - 9.4.1 企业发展概况
 - 9.4.2 企业经营状况
 - 9.4.3 企业芯片平台
 - 9.4.4 企业研发项目
- 9.5 华大半导体
 - 9.5.1 企业发展概况
 - 9.5.2 企业发展状况
 - 9.5.3 企业芯片平台
 - 9.5.4 企业研发项目
- 9.6 汇顶科技
 - 9.6.1 企业发展概况
 - 9.6.2 经营效益分析
 - 9.6.3 企业芯片平台
 - 9.6.4 企业研发项目
- 9.7 兆易创新
 - 9.7.1 企业发展概况
 - 9.7.2 经营效益分析
 - 9.7.3 企业芯片平台

9.7.4 企业研发项目

第十章 对芯片设计行业投资价值综合分析

10.1 对集成电路产业投资价值评估及投资建议

10.1.1 投资价值综合评估

10.1.2 市场机会矩阵分析

10.1.3 产业进入时机分析

10.1.4 产业投资风险剖析

10.1.5 产业投资策略建议

10.2 对芯片设计行业进入壁垒评估

10.2.1 行业竞争壁垒

10.2.2 行业技术壁垒

10.2.3 行业资金壁垒

10.3 对芯片设计行业投资状况分析

10.3.1 产业投资规模

10.3.2 产业投资热点

10.3.3 基金投资策略

10.3.4 投资项目分析

第十一章 对2022-2028年芯片设计行业发展趋势和前景预测分析 ()

11.1 中国芯片市场发展机遇分析

11.1.1 产业发展机遇分析

11.1.2 市场变动带来机遇

11.1.3 产业未来发展趋势

11.2 中国芯片设计行业发展前景展望

11.2.1 技术创新发展

11.2.2 市场需求状况

11.2.3 行业发展前景

11.3 对2022-2028年中国芯片设计行业预测分析

11.3.1 2022-2028年中国芯片设计行业影响因素分析

11.3.2 2022-2028年中国芯片设计行业销售规模预测

部分图表目录：

图表1 芯片产品分类

图表2 集成电路产业链及部分企业

图表3 芯片生产历程

图表4 芯片设计产业图谱

图表5 2016-2020年国内生产总值及其增长速度

图表6 2016-2020年三次产业增加值占国内生产总值比重

图表7 2020年中国GDP核算数据

图表8 2020年规模以上工业增加值至同比增长速度

图表9 2020年规模以上工业生产主要数据

图表10 2016-2020年规模以上工业增加值同比增长速度

图表11 2020年规模以上工业生产主要数据

图表12 智能制造系统架构

图表13 智能制造系统层级

图表14 MES制造执行与反馈流程

图表15 《中国制造2025》半导体产业政策目标与政策支持

图表16 2016-2020年IC产业政策目标与发展重点

图表17 国家支持集成电路产业发展的部分重点政策

图表18 中国芯片产业相关政策汇总（一）

图表19 中国芯片产业相关政策汇总（二）

图表20 一期大基金投资各领域份额占比

图表21 2016-2020年中国网民规模和互联网普及率

图表22 2016-2020年手机网民规模及其占网民比例

图表23 2016-2020年电子信息制造业增加值和出口交货值分月增速

图表24 2016-2020年电子信息制造业主营业务收入、利润增速变动情况

图表25 2016-2020年电子信息制造业PPI分月增速

图表26 2016-2020年电子信息制造业固定资产投资增速变动情况

图表27 2016-2020年通信设备行业增加值和出口交货值分月增速

图表28 2016-2020年电子元件行业增加值和出口交货值分月增速

图表29 2016-2020年电子器件行业增加值和出口交货值分月增速

图表30 2016-2020年计算机制造业增加值和出口交货值分月增速

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202206/302515.html>